

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2022-008

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

##### （二）2021年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	募集资金专户发生情况（人民币元）
募集资金总额	3,685,239,005.00
减：保荐承销费	173,832,028.54
募集资金初始金额	3,511,406,976.46

减：其他发行费用	30,148,456.12
实际募集资金净额	3,481,258,520.34
减：募投项目支出（注1）	671,137,898.48
减：手续费	53,914.15
加：利息收入	1,908,715.83
加：发行费用（以自筹资金预先投入）（注2）	8,636,173.92
加：尚未支付的发行费用（注3）	9,762,956.36
募集资金结余金额	2,830,374,553.82

注1：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）本期支出671,137,898.48元，不包含公司预先以自筹资金投入募投项目的资金，截至2021年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出。

注2：截至2021年12月31日，公司预先以自筹资金支付发行费用的资金尚未转出。

注3：尚未支付的发行费用含印花税870,532.26元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2021年11月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，上述监管协议履行正常。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（人民币元）
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121909929210918	活期存款	685,624,449.45
中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750180808738885	活期存款	417,417,608.44
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	452082279585	活期存款	12,199,700.17
上海银行股份有限公司张江支行	03004750062	活期存款	5,205,601.58
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121909929210858	活期存款	200,065,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002063	活期存款	300,958,599.52
招商银行股份有限公司上海淮海支行	121909929210202	活期存款	308,358,061.73
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156371	活期存款	300,097,500.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000444066	活期存款	300,097,500.00
中国工商银行股份有限公司上海市滴水湖支行	1001747729300001088	活期存款	300,097,500.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210666	活期存款	253,032.93
合计			2,830,374,553.82

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未转出。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

会计师事务所认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机

构对盛美上海2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2022年3月2日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 盛美半导体设备(上海)股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额(注1)				3,481,258,520.34		本年度投入募集资金总额(注2)					671,137,898.48	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					671,137,898.48	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1) (注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盛美半导体设备研发与制造中心	不适用	700,000,000.00	不适用	700,000,000.00	14,346,965.93	14,346,965.93	-685,653,034.07	2.05	2023 年	不适用 (注4)	不适用 (注4)	否
盛美半导体高端半导体设备研发项目	不适用	450,000,000.00	不适用	450,000,000.00	32,712,968.98	32,712,968.98	-417,287,031.02	7.27	不适用	不适用 (注5)	不适用 (注5)	否
补充流动资金	不适用	650,000,000.00	不适用	650,000,000.00	624,077,963.57	624,077,963.57	-25,922,036.43	96.01	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	671,137,898.48	671,137,898.48	-1,128,862,101.52	37.29				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2021 年 12 月 31 日,公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 3,481,258,520.34 元。

注 2：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出，故以自筹资金预先投入募投项目的金额未计入本年度投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：盛美半导体设备研发与制造中心项目仍处于建设初期。

注 5：盛美半导体高端半导体设备研发项目仍处于研发初期。